

概要

HP Z840 Workstation



1. オプティカルドライブ ベイ(スリムライン)
2. 外付け5.25インチ ベイ×2
3. 電源ボタン

4. HDD動作ランプ
5. 前面I/O: USB 3.0×4(うち1ポート充電機能付き(最上位))およびヘッドセット×1、マイク×1

概要



- 6. 1125 W/90%効率の電源を選択可能
- 7. DDR4 ECCメモリ用DIMMスロット×16
- 8. 2 外付け5.25インチ ベイ×2
- 9. 内蔵3.5インチ ベイ×4
- 10. 背面I/O:
 - 背面電源ボタン
 - USB 3.0 ×4
 - USB 2.0 ×2
 - 1 シリアル
 - PS/2キーボードおよびマウス
 - 2 RJ-45 - 内蔵ギガビットLAN
 - オーディオ ラインイン×1(マイクとして再割り当て可能)
 - オーディオ ラインアウト×1
- 11. 2 Intel XeonプロセッサE5-2600 v3ファミリ
- 12.
 - スロット1:PCIe Gen3 x4
 - スロット2:PCIe Gen3 x16
 - スロット3:PCIe Gen3 x8 - 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能
 - スロット4:PCIe Gen3 x16 - 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能
 - スロット5: 取り付けられているCPUが1つの場合はPCIe Gen2 x4。2つ目のCPUが取り付けられている場合はPCIe Gen3 x8
 - スロット6:PCIe Gen3 x16
 - スロット7:PCIe Gen2 x1
- 13. SATAポート×6、SASポート×8
- 14. USB 2.0ポート×2、USB 3.0ポート×1

概要

概要

フォーム ファクター
オペレーティング
システム

ラックマウント可能ミニタワー
プリインストール:

- Windows 8.1 Pro OS 64ビット*
- Microsoft Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能)**
- HP Installer Kit for Linux (RHEL 5および6の64ビットOSバージョンおよびSUSE Linux Enterprise Desktop 1 1用のドライバーを含む)

¹この2つ目のOSは、最初のOSとしてのHP Linux Installer Kitとともに注文する必要があります。

注:

Linuxの詳しいOS/ハードウェア サポート情報については、次を参照してください: http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix/ (英語サイト)

*一部の機能はWindowsの一部エディションまたはバージョンでは使用できません。システムでWindowsの機能を最大限に活用するには、アップグレードされたハードウェアや別売のハードウェア、ドライバーやソフトウェアが必要になる場合があります。 <http://www.microsoft.com/ja-jp/default.aspx> を参照してください。

**このシステムは、Windows® 7 Proソフトウェアにプリインストールされており、Windows 8.1 Proソフトウェア用のライセンスおよびメディアも付属しています。同時にWindowsソフトウェアのバージョンを1つだけ使用できます。バージョンを切り替えるには、一方のバージョンをアンインストールしてから、もう一方のバージョンをインストールする必要があります。データの損失を回避するために、オペレーティング システムをアンインストールおよびインストールする前にすべてのデータ(ファイル、写真など)をバックアップする必要があります。

使用可能なプロセッサ

名称	クロック 速度 (GHz)	コア	キャッシュ (MB)	メモリ 速度 (MHz)	QPI 速度 (GT/秒)	ハイパー スレディング	Intel® vPro™ テクノロジー搭載	Intel®ターボ ブースト テクノロジー ¹	TDP (W)
INTEL® XEON® E5-2699 v3 プロセッサ	2.3	18	45	2133	9.6	対応	対応	5/13	145
INTEL® XEON® E5-2687W v3 プロセッサ	3.1	10	25	2133	9.6	対応	対応	1/4	160
INTEL® XEON® E5-2690 v3 プロセッサ	2.6	12	30	2133	9.6	対応	対応	5/9	135
INTEL® XEON® E5-2643 v3 プロセッサ	3.4	6	20	2133	9.6	対応	対応	2/3	135
INTEL® XEON® E5-2637 v3 プロセッサ	3.5	4	15	2133	9.6	対応	対応	1/2	135
INTEL® XEON® E5-2620 v3 プロセッサ	2.4	6	15	1866	8.0	対応	対応	2/8	85
INTEL® XEON® E5-2603 v3 プロセッサ	1.6	6	15	1600	6.4	非対応	対応	N/A	85

¹この列に示されている仕様は、すべてのコアの最大ターボ ステップ数、1つのコアの最大ターボ ステップ数を表しています。ターボ ブースト ステップは、100 MHzきざみで発生します。ターボ機能を持たないプロセッサは「N/A」と表されています。

概要

免責事項

マルチコアは、特定のソフトウェア製品のパフォーマンス向上を意図して設計されています。一部のお客様またはソフトウェア アプリケーションは、このテクノロジーの使用によって恩恵を受けません。64ビットのコンピューティングシステムが必要です。パフォーマンスは、ハードウェアおよびソフトウェア構成によって異なります。Intelのナンバリングは、より高いパフォーマンスを評価するものではありません。

フォーム ファクター

ラックマウント可能ミニタワー

カラー

黒/ヘマタイト

I/Oスロット(詳しくは、システムボードのセクションを参照してください)

スロット1:PCIe Gen3 x4
スロット2:PCIe Gen3 x16
スロット3:Gen3 x8 - 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能
スロット4:Gen3 x16 - 2つ目のプロセッサが取り付けられている場合のみ使用可能
スロット5:取り付けられているCPUが1つの場合はPCIe Gen2 x4。2つ目のCPUが取り付けられている場合はPCIe Gen3 x8
スロット6:PCIe Gen3 x16
スロット7:PCIe Gen2 x1

PCIe x8コネクタはオープン エンド、PCIe x16カードをスロットに取り付け可能

ベイ(詳しくは、ストレージのセクションを参照してください)

ベイの総数 = 7
内蔵3.5インチストレージ ベイ×4
外付け5.25インチ ベイ×2

概要

内蔵ベイ	外付けスリムライン オプティカル ベイ×1 内蔵3.5インチ ベイ×4(すべて音響減衰レーン アセンブリが装着済み)
外付けベイ	外付け5.25インチ ベイ×2 <ul style="list-style-type: none">• 上部のベイのデバイス奥行き制限: 206 mm• 下部のベイのデバイス奥行き制限: 206 mm
前面I/O	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0×4• コンボ ヘッドセット×1• マイク×1
背面I/O	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0×4• USB 2.0×2• シリアル×1• PS/2キーボードおよびマウス• RJ-45 - 内蔵ギガビットLAN×2• オーディオ ラインイン×1(マイクとして再割り当て可能)• オーディオ ラインアウト×1
内蔵USB	<ul style="list-style-type: none">• 1つの2x5ヘッダーで使用可能なUSB 2.0ポート×2。• 9ピンのシュラウド コネクタで使用可能なUSB 3.0ポート×1。2x5ヘッダーは1つのHP内蔵USBポート キット (EM165AA)をサポート。
シャーシ寸法(高さ×幅×奥行き)	44.4×20.3×52.5 cm(17.5×8.0×20.7インチ)
システム質量	正確な質量は構成によって異なります。 <ul style="list-style-type: none">• 最小構成: 21.1 kg(46.7ポンド)• 標準構成: 22.8 kg(50.4ポンド)• 最大構成: 29.2 kg(64.3ポンド)
動作保証温度	動作時: 5° ~ 35° C(40° ~ 95° F) 非動作時: -40° ~ 70° C(-40° ~ 158° F)
湿度	動作時: 8~85% 非動作時: 8~90%
動作保証高度(非加圧)	動作時: 3,048 m(10,000フィート) 非動作時: 9,100 m(30,000フィート)
電源装置	<ul style="list-style-type: none">• 1125 W/90%効率のワイドレンジ、アクティブな電圧自動補正機能 <p>注:1125 W電源では、入力電圧が105 Vを超える場合に1275 Wの出力を供給することもできます。入力電圧が105 V未満であっても、何らかの理由により90 Vを超える場合、引き出される最大出力は1125 Wになります。1275 Wの出力が必要な場合は、無停電電源(UPS)の使用を強くおすすめします。 1125 W電源では、どのような状況でも入力電圧が180 Vを超える場合は、1450 Wの出力を供給することもできます。Z820電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください。</p>

概要

1125W - [http://www.pluginloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT%20PACKARD_623196-001_ECOS%202921_1125W_Report\(1275w\).pdf](http://www.pluginloadsolutions.com/psu_reports/HEWLETT%20PACKARD_623196-001_ECOS%202921_1125W_Report(1275w).pdf) (英語サイト)

高電源設定に対する特殊なサポートの承認については、HPの担当窓口にお問い合わせください。

サポートされる インターフェイス

- 6チャンネルSATA 6.0 Gb/sインターフェイス
- 8チャンネル6 Gb SASインターフェイス
 - ・ マザーボード上にSASコネクタ×8、SAS/バルクヘッドおよびバックパネル コネクタ キットを使って、SASポートを外部に移動可能
- USB 3.0、USB 2.0

サポートされる ハードディスクドライブ コントローラー ワークステーションISV 認定

SATAおよびSASコントローラー

以下の最新の認定一覧を参照してください。

<http://www.hp.com/united-states/campaigns/workstations/partnerships.html> (英語サイト)

システム技術仕様

システム ボード	
システム ボード フォーム ファクター	カスタム フォーム ファクター、13インチ × 14.3インチ (330.2 mm × 362.0 mm)
プロセッサ ソケット	デュアルLGA2011-3
CPUバス速度	QPI: 最大9.6 GT/秒、デュアル リンク実装
チップセット	Intel® C612チップセット
スーパーI/Oコントローラー	Nuvoton NPCD379H
メモリ拡張スロット	16スロット (CPUあたり8スロット)
サポートされるメモリの種類	DDR4 R-DIMM (レジスタ付き)、ECC: 4 GB、8 GB、および16 GB DDR4 LR-DIMM (低負荷)、ECC: 32 GB (64 GBおよび128 GBは初期リリース後に追加)
メモリ モード	NUMA (Non-Uniform Memory Access)、メモリ ノード インターリーブ
サポートされるメモリの速度	1600 MHz、1866 MHz、および2133 MHz

シングル プロセッサCPU0

容量	注	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4	DIMM5	DIMM6	DIMM7	DIMM8	評価
4 GB	*	4 GB								適正
8 GB		4 GB 8 GB							4 GB	適切 適正
12 GB		4 GB		4 GB					4 GB	より適切
16 GB		4 GB 8 GB		4 GB			4 GB		4 GB 8 GB	最適 適切
32 GB		4 GB 8 GB 16 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB 8 GB 16 GB	最適 最適 適切
48 GB	~	8 GB	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB	8 GB	4 GB	8 GB	最適
64 GB		8 GB 16 GB	8 GB	8 GB 16 GB	8 GB	8 GB	8 GB 16 GB	8 GB	8 GB 16 GB	最適 最適
96 GB	~	16 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	16 GB	最適
128 GB		16 GB 32 GB	16 GB	16 GB 32 GB	16 GB	16 GB	16 GB 32 GB	16 GB	16 GB 32 GB	最適 最適
256 GB	~	32 GB 64 GB	32 GB	32 GB 64 GB	32 GB	32 GB	32 GB 64 GB	32 GB	32 GB 64 GB	最適 最適
512 GB	~	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB 128 GB	最適 最適
1 TB	~	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	最適

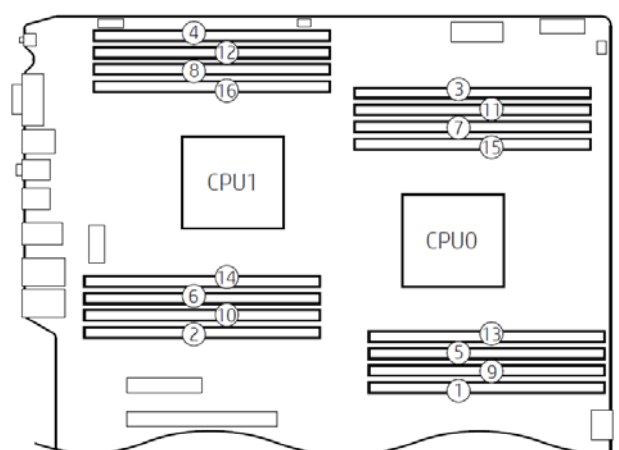
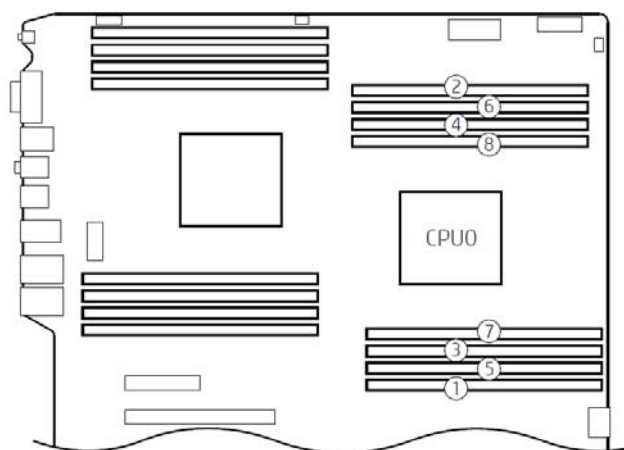
適正<適切<より適切<最適、の順番でパフォーマンスが良くなる傾向があります

システム技術仕様

		デュアル プロセッサ																
		CPU0								CPU1								
容量 (GB)	注	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4	DIMM 5	DIMM 6	DIMM 7	DIMM 8	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4	DIMM 5	DIMM 6	DIMM 7	DIMM 8	評価
8 GB		4 GB								4 GB								適正
16 GB		4 GB 8 GB							4 GB	4 GB 8 GB							4 GB	適切 適正
32GB		4 GB 8 GB 16 GB		4 GB			4 GB		4 GB 8 GB	4 GB 8 GB 16 GB		4 GB			4 GB		4 GB 8 GB	最適 適切 適正
64 GB		4 GB 8 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB 8 GB	4 GB	4 GB	4 GB 8 GB	最適 最適
96 GB		8 GB	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB	8 GB	4 GB	8 GB	8 GB	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB	8 GB	4 GB	8 GB	最適
128 GB		8GB 16 GB 32 GB	8 GB	8GB 16 GB	8 GB	8GB	8 GB 16 GB	8 GB	8GB 16 GB 23 GB	8GB 16 GB 32 GB	8 GB	8GB 16 GB	8 GB	8 GB	8GB 16 GB	8 GB	8GB 16 GB 32 GB	最適 最適 適切
192 GB		16 GB 16 GB	8 GB 16GB	16 GB 16 GB	8 GB	8 GB	16 GB 16 GB	8 GB 16GB	16 GB 16 GB	16 GB 16 GB	8 GB 16GB	16 GB 16 GB	8 GB	8 GB	16 GB 16 GB	8 GB 16GB	16 GB 16 GB	最適 より適切
256 GB		16 GB 32 GB	16GB	16 GB 32 GB	16GB	16GB	16 GB 32 GB	16GB	16 GB 32 GB	16 GB 32 GB	16GB	16 GB 32 GB	16GB	16GB	16 GB 32 GB	16GB	16 GB 32 GB	最適 最適
512 GB		32 GB 64 GB	32GB	32 GB 64 GB	32GB	32GB	32 GB 64 GB	32GB	32 GB 64 GB	32 GB 64 GB	32GB	32 GB 64 GB	32GB	32GB	32 GB 64 GB	32GB	32 GB 64 GB	最適 最適
1 TB		64 GB 128 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB	64 GB 128 GB	64 GB	64 GB 128 GB	最適 最適
2 TB		128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	128 GB	最適
スロットへの 取り付け		1	9	5	13	15	7	11	3	2	10	6	14	16	8	12	4	

適正 < 適切 < より適切 < 最適、の順番でパフォーマンスが良くなる傾向があります

メモリ取り付け順序:



最大メモリ

RDIMM使用時: 最大256 GBをサポート
LRDIMM使用時: 最大1024 GBをサポート
LRDIMM使用時: 最大2048 GBをサポート

メモリ構成
(サポート対象)

- 上記以外にも可能なメモリ構成があります。
- ECC DIMMのみがサポートされています。
- UDIMM(バッファなし)、RDIMM(レジスタ付き)、およびLR DIMM(低負荷)メモリを混在させることはできません。システムに取り付けられているすべてのメモリが、UDIMM、RDIMM、またはLR DIMMのどれかである必要があります。

システム技術仕様

	<ul style="list-style-type: none"> • 対応するプロセッサがインストールされていない場合は、メモリ モジュールをメモリ スロットに取り付けずにください。 • メモリ モジュールが1つのプロセッサのみに対して取り付けられるデュアル プロセッサ構成はサポートされていません。 • Z840は初期リリースでは最大512 GBをサポートします。 • Z840の次の初期リリースで64 GB DIMMのサポートが追加された場合、Z840は1024 GBまでサポートするようになります。 • Z840の次の初期リリースで128 GB DIMMのサポートが追加された場合、Z840は2,048 GBまでサポートするようになります。 	
PCI Expressコネクタ	<p>PCIe Gen3 x16(ラッチ付き) × 2 PCIe Gen3 x16(ラッチ付き) × 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • オプションの2つ目のCPUが取り付けられている場合のみ使用可能。 <p>PCIe Gen3 x8オープンエンド コネクタ × 1。</p> <ul style="list-style-type: none"> • オプションの2つ目のCPUが取り付けられている場合のみ使用可能。 <p>PCIe x8オープンエンド コネクタ × 1。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CPUが1つ取り付けられている、1つのPCIe Gen2 x4スロットで使用可能 • 2つ目のCPUが取り付けられている、1つのPCIe Gen3 x8で使用可能 <p>PCIe Gen3 x4オープンエンド コネクタ × 1。 PCIe Gen2 x1オープンエンド コネクタ × 1。</p>	
サポート対象のドライブ インターフェイス		
	SATA	sSATA @6 Gb/s、RAID 0、1、5、10、およびNCQをサポートします。 工場出荷時に内蔵されるRAIDはMicrosoft Windowsのみです。
	Serial Attached SCSI	HW RAID 0、1、10を備えた内蔵8チャネルSAS 6.0 Gb/秒コントローラー10
	内蔵RAID	SATA: RAID 0、1(1つのRAIDをサポート) SATA: RAID 0、1、5、10(最大2つのRAIDをサポート) SAS: HW RAID 0、1、10(最大2つのRAIDをサポート)
	内蔵グラフィックス	なし
	ネットワーク コントローラー	内蔵Intel I218LM メモリ内蔵3 KB受信バッファおよび3 KB送信バッファ サポートされるデータ速度: 10/100/1000 Mb/秒 準拠規格: IEEE 802.1as、802.1p、802.1Q、802.3、802.3ab、802.3az、802.3i、802.3u、802.3x、802.3z バス アーキテクチャー: PCIe 1.0 x1およびSMBus 電源要件: 0.5 W ブートROMサポート ネットワーク転送速度: 10BASE-T(半二重) 10 Mb/s

システム技術仕様

		<p>10BASE-T(全二重)20 Mb/秒 100BASE-TX(半二重)100 Mb/秒 100BASE-TX(全二重)200 Mb/秒 1000BASE-T(全二重)2000 Mb/秒 管理機能:WOL、自動MDIクロスオーバー、PXE、マルチポート チーミング、RSS、高度なケーブル診断</p> <p>AMT 9.1サポート、vPro準拠</p> <p>内蔵I210AT</p> <p>FIFOパケット バッファのメモリは送信24 KB、受信16 KBまで調整可能 10/100/1000 Mb/秒のデータ レートに対応 準拠規格:IEEE 802.1as、802.1q、802.1Q、802.3、802.3ab、802.3ap、802.3az、802.3u、802.3x、802.3z</p> <p>バス アーキテクチャー:PCIe 1.0 x1およびSMBus ブートROMサポート ネットワーク転送速度: 10BASE-T(半二重)10 Mb/秒 10BASE-T(全二重)20 Mb/秒 100 BASE-TX(半二重)100 Mb/秒 100BASE-TX(全二重)200 Mb/秒 1000BASE-T(全二重)2000 Mb/秒 管理機能:WOL、自動MDIクロスオーバー、PXE、マルチポート チーミング、RSS、高度なケーブル診断</p>
	PCI-Xコネクタ	なし
	PCIカード ガイド	あり
	ウェイク オンLAN	あり(両方のコネクタ)
	内蔵Trusted Platform Module	Infineon TPM 1.2認証(TPM2.0認証、ハードウェア対応。初期リリースでは使用不可)
IEEE1394コネクタ	前面	なし
	背面	なし
	内蔵	なし
USBコネクタ	前面	USB 3.0×4
	背面	USB 3.0×4 USB 2.0×2
	内蔵	<p>1 1つの2x10ヘッダーで使用可能なUSB 3.0×1およびUSB 2.0ポート×1。このヘッダーはUSBメディア スロットに対応します。</p> <p>2 1つの2x5ヘッダーで使用可能なUSB 2.0ポート×2。このヘッダーはHP内蔵USBポート キット(EM165AA)をサポートします。他社製のアダプターも使用可能です。</p>
HD内蔵オーディオ	Realtek ALC221	
フラッシュROM	あり	
CPUファン ヘッダー	CPUファンおよびメモリ ファン用のヘッダー(ブラインド メイト)×1	
シャーシ ファン ヘッダー	シャーシ ファン ヘッダー×1	

システム技術仕様

前面PCIファン ヘッダー	前面PCIファン ヘッダー×2	
前面コントロール パネル/スピーカー ヘッダー	あり	
CMOSバッテリー ホルダー - リチウム	あり	
電源装置ヘッダー	あり	
電源スイッチ、電源ランプ、およびハードディスクドライブLEDヘッダー	前面の電源スイッチ、前面の電源およびハードディスクドライブLED。背面の電源スイッチおよび背面の電源ランプ。システム ボード上のドライブ ランプ ヘッダー。	
パスワード クリア ジャンパー	あり	
シリアル ポート	あり。背面パネル上	
パラレル ポート	なし	
キーボード/マウス	あり	
電源装置	1125 W/1275 W*/1450 W* 90%効率、カスタムPSU (ワイドレンジ、アクティブPFC)	
動作電圧範囲	90~269 VAC	
定格電圧範囲	100 VAC 115~127 VAC 200~240 VAC	118 VAC
定格周波数	50/60 Hz	400 Hz
動作周波数範囲	47~66 Hz	393~407 Hz
定格入力電流	12A @ 100 VAC 12A @ 115~127 VAC 10A @ 200~240 VAC	12A @ 118 VAC
放熱(構成/ソフトウェアによって異なります)	通常 = 2773 btu/時 (699 kg-cal/時) 最大 = 3878 btu/時 (977 kg-cal/時) 最大 = 5002 btu/時 (1260 kg-cal/時) 最大 = 5624 btu/時 (1417 kg-cal/時)	
電源装置ファン	(2) 80 × 25 mm (可変速)	
国際エネルギー スター プログラムに準拠 (構成によって異なります)	あり	
電源供給装置の効率	90%効率 Z840 1125 W電源供給装置の効率に関するレポートについては、このリンクを参照してください: 未定	
115 VでFEMPスタンバイ電源準拠 (S5で2 W未満 - 電源切断)	あり	
230 VでEuP準拠 (S5で0.5 W未満 - 電源切断)	あり	
220 VでCECP準拠 (S3で4 W未満 - RAMにサスペンド)	あり。構成によって異なります	
スリープ モードでの電力消費 (国際エネルギー スターの定義どおり) - RAMにサスペンド(S3) (すぐに利用可能なPC)	35 W未満	
内蔵セルフ テスト ランプ	あり	
耐サージ機能付フルレンジ連続供給電源装置 (最大2000 Vの電力サージに耐えます)	あり	

システム技術仕様

		* 入力電圧の制限があります
		注: 1125 W電源では、入力電圧が105 Vを超える場合に1275 Wの出力を供給することもできます。入力電圧が105 V未満であっても、何らかの理由により90 Vを超える場合、引き出される最大出力は1125 Wになります。1275 Wの出力が必要な場合は、無停電電源(UPS)の使用を強くおすすめします。1125 W電源では、どのような状況でも入力電圧が180 Vを超える場合は、1450 Wの出力を供給することもできます。
AUXイン(オーディオ)	なし	
CMOSクリア ボタン	あり	
マルチベイ ヘッダー	なし	
内蔵Gigabit Ethernet	あり。デュアル ポート	
アクセス パネル ソレノイド ロック ヘッダー	なし	
アクセス パネル侵入センサーヘッダー	あり。前面UI(コントロール パネル)ケーブル ヘッダーの一部	
メモリ ファン コネクタ	あり。ブラインドメイト	

システム構成 (日本では構成できないものも含まれます)

構成例 #1	プロセッサ情報	Intel Xeon E5-2609v3(6コア)85W × 1					
	メモリ情報	16GB DDR4-2133(2 × 8 GB)1CPU RegRAM					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro K620 × 1					
	ディスク/オプティカル/ディスク ケット	500 GB SATA 7200 × 1/DVD-ROM SATA × 1					
	電源装置	850 W 88%カスタムPSU					
	その他	-					
	エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
Windowsアイドル(S0)		103.41 W		102.23 W		103.92 W	
Windowsビジー標準(S0)		183.75 W		181.88 W		189.37 W	
Windowsビジー最大(S0)		204.93 W		201.28 W		206.74 W	
スリープ(S3)		3.711 W	3.587 W	3.785 W	3.711 W	3.587 W	3.785 W
オフ(S5)		1.053 W	0.992 W	1.159 W	1.053 W	0.992 W	1.159 W
ゼロ パワー モード(ErP)		0.182 W		0.298 W		0.172 W	
放熱効率** (Btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
	Windowsアイドル(S0)	352.83 btu/時		348.81 btu/時		354.58 btu/時	
	Windowsビジー標準(S0)	626.96 btu/時		620.57 btu/時		646.13 btu/時	
	Windowsビジー最大(S0)	699.22 btu/時		686.77 btu/時		705.40 btu/時	
	スリープ(S3)	12.66 btu/時	12.24 btu/時	12.91 btu/時	12.66 btu/時	12.24 btu/時	12.91 btu/時
	オフ(S5)	3.59 btu/時	3.38 btu/時	3.95 btu/時	3.59 btu/時	3.38 btu/時	3.95 btu/時
	ゼロ パワー モード(ErP)	0.621 btu/時		1.018 btu/時		0.586 btu/時	

構成例 #2 (国際エネルギー スター プログラムに準拠)	プロセッサ情報	Intel Xeon E5-2640v3(8コア)90W × 2					
	メモリ情報	32 GB DDR4-2133(8x4 GB)2CPU RegRAM					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro K2200 × 1					

システム技術仕様

	ディスク/オプティカル/ディスク	500 GB SATA 7200×1/DVD-ROM SATA×3					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					
エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
	Windowsアイドル(S0)	1242.17 W		141.01 W		142.47 W	
	Windowsビジー標準(S0)	324.18 W		320.33 W		323.91 W	
	Windowsビジー最大(S0)	398.27 W		396.25 W		398.75 W	
	スリープ(S3)	6.08 W	6.03 W	6.13 W	6.08 W	6.03 W	6.13 W
	オフ(S5)	1.04 W	0.99 W	1.10 W	1.04 W	0.99 W	1.10 W
	ゼロ パワー モード(ErP)	0.181 W		0.308 W		0.172 W	
放熱効率** (Btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
	Windowsアイドル(S0)	485.08 btu/時		481.13 btu/時		486.11 btu/時	
	Windowsビジー標準(S0)	1106.10 btu/時		1092.97 btu/時		1105.18 btu/時	
	Windowsビジー最大(S0)	1358.90 btu/時		1352.01 btu/時		1360.54 btu/時	
	スリープ(S3)	20.75 btu/時	20.57 btu/時	20.91 btu/時	20.75 btu/時	20.57 btu/時	20.91 btu/時
	オフ(S5)	3.55 btu/時	3.38 btu/時	3.76 btu/時	3.55 btu/時	3.38 btu/時	3.76 btu/時
	ゼロ パワー モード(ErP)	0.619 btu/時		1.051 btu/時		0.587 btu/時	

構成例 #3	プロセッサ情報	Intel Xeon E5-2680v3(12コア)120W×2					
	メモリ情報	64 GB DDR4-2133(8x8 GB)2CPU RegRAM					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro K4200×1					
	ディスク/オプティカル/ディスク	300 GB SAS 15K×2/SuperMulti DVDRW SATA×2					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					
	エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC
		LAN有	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
Windowsアイドル(S0)		123.26 W		121.40 W		124.07 W	
Windowsビジー標準(S0)		413.33 W		393.34 W		412.26 W	
Windowsビジー最大(S0)		496.46 W		483.26 W		498.07 W	
スリープ(S3)		7.114 W	7.086 W	7.148 W	7.114 W	7.086 W	7.148 W
オフ(S5)		1.054 W	0.993 W	1.161 W	1.054 W	0.993 W	1.161 W
ゼロ パワー モード(ErP)		0.181 W		0.307 W		0.177 W	
放熱効率** (Btu/時)		115 VAC		230 VAC		100 VAC	
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
	Windowsアイドル(S0)	420.56 btu/時		414.22 btu/時		423.33 btu/時	
	Windowsビジー標準(S0)	1410.28 btu/時		1342.08 btu/時		1406.63 btu/時	
	Windowsビジー最大(S0)	1693.95 btu/時		1648.88 btu/時		1700.10 btu/時	
	スリープ(S3)	24.27 btu/時	24.17 btu/時	24.39 btu/時	24.27 btu/時	24.17 btu/時	24.39 btu/時
	オフ(S5)	3.597 btu/時	3.388 btu/時	3.962 btu/時	3.597 btu/時	3.388 btu/時	3.962 btu/時

システム技術仕様

	ゼロ パワー モード (ErP)	0.619 btu/時	1.049 btu/時	0.607 btu/時 btu/時
--	------------------	-------------	-------------	-------------------

構成例 #4	プロセッサ情報	Intel Xeon E5-2697v3 (14コア) 145W × 2							
	メモリ情報	64 GB DDR4-2133 (16x4 GB) 2CPU RegRAM							
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro K5200 × 2							
	ディスク/オプティカル/ディスクセット	300 GB SAS 15K × 2 / SuperMulti DVDRW SATA × 4							
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU							
	その他	-							
	エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC		
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効		
Windowsアイドル (S0)		141.75 W		140.45 W		141.63 W			
Windowsビジー標準 (S0)		510.66 W		498.90 W		510.82 W			
Windowsビジー最大 (S0)		569.34 W		559.38 W		568.48 W			
スリープ (S3)		6.454 W	3.669 W	6.497 W	6.454 W	3.669 W	6.497 W		
オフ (S5)		1.105 W	0.987 W	1.165 W	1.105 W	0.987 W	1.165 W		
ゼロ パワー モード (ErP)		0.180 W		0.306 W		0.178 W			
放熱効率** (Btu/時)		LAN有効		LAN無効		LAN有効		LAN無効	
	Windowsアイドル (S0)	483.65 btu/時		497.22 btu/時		483.24 btu/時			
	Windowsビジー標準 (S0)	1742.37 btu/時		1702.25 btu/時		1742.91 btu/時			
	Windowsビジー最大 (S0)	1942.29 btu/時		1908.60 btu/時		1939.65 btu/時			
	スリープ (S3)	22.02 btu/時	21.63 btu/時	22.16 btu/時	22.02 btu/時	21.63 btu/時	22.16 btu/時		
	オフ (S5)	3.77 btu/時	3.37 btu/時	3.97 btu/時	3.77 btu/時	3.37 btu/時	3.97 btu/時		
	ゼロ パワー モード (ErP)	0.616 btu/時		1.046 btu/時		0.608 btu/時			

構成例 #5 (国際エネルギー スター プログラムに準拠)	プロセッサ情報	Intel Xeon 2687Wv3 (10コア) 160W × 2					
	メモリ情報	512 GB DDR4-2133 (16x32 GB) 2CPU LR RAM					
	グラフィックス情報	NVIDIA Quadro K6000 × 2					
	ディスク/オプティカル/ディスクセット	300 GB 10K SAS SFF × 6 / SuperMulti DVDRW SATA × 1					
	電源装置	1125 W 90%カスタムPSU					
	その他	-					
	エネルギー消費		115 VAC		230 VAC		100 VAC
		LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効	LAN有効	LAN無効
アイドル (国際エネルギー スター アイドル (S0))		174.56 W		173.77 W		175.26 W	
国際エネルギー スター PMAX Windows LinpackおよびViewperf動作時		561.98 W		559.23 W		567.75 W	
国際エネルギー スター "スリープ" (S3)		16.426 W	16.279 W	16.099 W	16.426 W	16.279 W	16.099 W
国際エネルギー スター "スタンバイ" (オフ) (S3)		1.047 W	0.997 W	1.144 W	1.047 W	0.997 W	1.144 W
放熱効率**	115 VAC		230 VAC		100 VAC		

システム技術仕様

(BTU/時)		LAN有効	LAN有効	LAN有効	LAN有効	LAN有効	LAN有効
	アイドル (国際エネルギー スター アイドル(S0))		595.60 btu/時		592.90 btu/時		597.99 btu/時
国際エネルギー スター-PMAX Windows LinpackおよびViewp erf動作時		1917.48 btu/時		1908.09 btu/時		1937.16 btu/時	
国際エネルギー スター” スリープ”(S3)		56.046 btu/時	55.545 btu/時	54.935 btu/時	56.046 btu/時	55.545 btu/時	54.935 btu/時

定格騒音規制(エントリレベルおよびハイエンド構成)

システム構成 (エントリ レベル)	プロセッサ情報	-
	メモリ情報	-
	グラフィックス情報	-
	ディスク/オプティカル/ディス ケット	-

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296準 拠)		サウンド出力(LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
アイドル		-	-
ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)		-	-
DVD-ROM動作時 (シーケンシャル読み取り)		-	-

システム構成 (ハイエンド)	プロセッサ情報	-
	メモリ情報	-
	グラフィックス情報	-
	ディスク/オプティカル/ディス ケット	-

定格騒音規制 (ISO 7779およびISO 9296準 拠)		サウンド出力(LWAd、ベル)	デスク側のサウンド圧力 (LpAm、デシベル)
アイドル		-	-
ハードディスクドライブ動作時 (ランダム読み取り)		-	-
DVD-ROM動作時 (シーケンシャル読み取り)		-	-

環境データ

環境条件	動作保証温度	動作時: 5~35° C(40~95° F) 非動作時: -40~60° C(-40~140° F)
	湿度	動作時: 8~85%のRH(結露なし) 非動作時: 8~90%のRH(結露なし)
	動作保証高度	動作時: 3,000 m(10,000フィート)

システム技術仕様

		非動作時: 9,100 m (30,000フィート)
	動力(新規)	<p>衝撃</p> <p>動作時: 1/2正弦波: 40 g、2~3 ms (~62 cm/s)</p> <p>非動作時:</p> <p>1/2正弦波: 160 cm/s、2~3 ms (~105 g)</p> <p>矩形波: 422 cm/s、20 g</p> <p>注: 値は1回の衝撃に対するものであり、連続した衝撃に対しては当てはまりません。</p> <p>振動</p> <p>ランダム動作時: 0.5 g (rms)、5~300 Hz、最大0.0025 g²/Hz</p> <p>非ランダム動作時: 2.0 g (rms)、5~500 Hz、最大0.0150 g²/Hz</p> <p>注: 値は連続振動には当てはまりません。</p>
	冷却	1524 m (5,000フィート)を超える海拔では、最大動作温度は、高度が30,480.0 cm (1,000フィート)増加するごとに1° C (1.8° F)下がります。

物理セキュリティおよび保守性

アクセス パネル	工具不要 システム ボードおよびメモリ情報が含まれます
オプティカルドライブ	工具不要、キャリアまたはレール不要
ハードディスクドライブ	工具不要
拡張カード	工具不要
プロセッサ ソケット	工具不要
緑色のユーザー タッチ ポイント	あり。工具不要、シャーシ内蔵コンポーネント
色分けされたケーブルおよび コネクタ	あり
メモリ	工具不要
システム ボード	工具不要、前面PCIカード ガイドで保持
コンピューター前面のデュアル カラーの電源およびHD L ED	あり
構成レコード ソフトウェア	あり
画面上の過熱警告	あり
復元用CD/DVDセット	コンピューターを最初の工場出荷時イメージに復元します。HPサポートから入手できます
デュアル機能の前面電源 スイッチ	あり。4秒押し続けるとフェイルセーフの電源切断が発生します
南京錠サポート	なし
ケーブル ロック サポート	あり。ケンジントン社製ケーブル ロック(オプション): システム全体の盗難のみを防止します。システム背面の3 m m × 7 mmスロット
ユニバーサル シャーシ クランプ ロック サポート	なし
ソレノイド ロックおよび フード センサー	なし
背面ポート制御カバー	なし
シリアル、パラレル、USB、 オーディオ、ネットワーク、 ポートの有効化/無効化	あり

システム技術仕様

制御	
リムーバブルメディアの書き込み/起動制御	あり。サポート対象のデバイスでリムーバブルメディアからの起動を防止します(およびメディアへの書き込みを無効にすることができます)
電源投入時パスワード(Power-on Password)	あり。権限のないユーザーがワークステーションを起動できないようにします
セットアップパスワード	あり。権限のないユーザーがワークステーションの構成を変更できないようにします
システムPCA上の3.3 V Aux電源ランプ	なし
NIC LED(内蔵)(緑色およびオレンジ色)	あり
CPUおよびヒートシンク	CPUを取り外すには、CPUヒートシンクをT-15型のネジ回しが必要になります。CPUの取り外しは工具不要です
電源装置診断LED	あり
前面電源ボタン	あり
前面電源ランプ	あり。白色(正常)、赤色(障害)
前面のハードディスクドライブ動作ランプ	あり。白色
前面のODD動作ランプ	あり
内蔵スピーカー	あり
システム/緊急ROMフラッシュリカバリ	破損したシステムBIOSをリカバリします
冷却装置	空冷式強制対流
電源装置ファン	80 mm × 25 mm × 2
CPUヒートシンクファン	92 × 25 mm 5ワイヤーPWM(各CPU)
シャーシファン	背面: 92 mm × 25 mm × 2 前面(850 W構成): 92 mm × 25 mm × 1(上部) 前面(1125 W構成): 92 mm × 25 mm × 2
メモリヒートシンクファン	75 × 90 × 35 mmメモリ空冷ファン 80 × 25 mm4ワイヤーPWファン
HP Vision Diagnostics Offline Edition	<p>HP Vision Diagnostics Offline Edition 診断ユーティリティを使用すると、テストを実行し、さまざまなソースからの重要なコンピューターハードウェアおよびソフトウェア構成情報を表示できます。このユーティリティでは、以下の操作ができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 診断の実行 システムのハードウェア構成の表示 <p>主な機能および利点 [HP Vision Diagnostics]により、ハードウェアの問題を効率的に特定、診断、および分離するための作業が簡素化されます。堅牢な管理ツールに加え、サービスツールがシステムの問題の迅速な解決にとって有益である場合があります。サービスプロセスを効率化し、問題を迅速に解決するには、HPのサポート窓口への問い合わせが行われる時点で適切な情報が利用可能になっている必要があります。必要となる主な情報(可能性があるシステムの問題に対する最大の洞察を提供する情報でもあります)は、システムの構成です。[HP Vision Diagnostics]は、システム可用性の向上に役立ちます。[HP Vision Diagnostics]の標準的な用途は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 明らかなハードウェア障害のテストおよび診断 アップグレード計画、標準化、インベントリ追跡、障害復旧、および保守用のシステム構成のドキュメント化

システム技術仕様

	<ul style="list-style-type: none"> より詳しい分析のための別の場所への構成情報の送信
アクセス パネル キー ロック	あり。アクセス パネルおよびすべての内蔵コンポーネント(オプティカルドライブおよびディスクドライブを含む)の取り外しを防止します
ACPI対応ハードウェア	ACPI(Advanced Configuration and Power Management Interface)。 <ul style="list-style-type: none"> システムは低電力モードから復帰できます。 システムの電力消費を制御して、個々のカードおよび周辺機器を、システムの他の要素に影響を及ぼすことなく、低電力または電源切断状態にすることを可能にします。
Trusted Platform Module チップ	あり
内蔵シャーシ ハンドル	あり、前面および背部
電源装置	工具不要、直接接続(ブラインドメイト)
PCIeカード固定	あり、背面(すべて)、中央(フルハイト カード)、前面(フルレンジス、エクステンダー カード付き)
フラッシュROM	あり。SPI ROM
ボード上の診断電源スイッチ ランプ	あり
パスワード クリア ジャンパー	あり
CMOSクリア ボタン	あり
CMOS/バッテリー ホルダー	あり
DIMMコネクタ	あり

BIOS

BIOS 32ビット サービス	Standard BIOS 32-bit Service Directory Proposal v0.4 BIOSが32ビットおよび64ビットのオペレーティング システムをサポート。
PCI 3.0サポート	業界標準インターフェイス経由でのPCI Expressの完全BIOSサポート。
ATAPI	ATAPI Removable Media Device BIOS Specificationバージョン1.0。
BBS	BIOS Boot Specification v1.01
WMIサポート	WMIは、マイクロソフトによるWBEM(Web-Based Enterprise Management)のWindows向けの実装です。WMIは、DMTF(Distributed Management Task Force) CIM(Common Information Model)およびWBEM仕様に完全に準拠しています。
BIOS Boot Spec 1.01+	ワークステーションの起動方法および起動元デバイスを細かく制御できます。
BIOS電源投入	ユーザーは、システムの電源を入れる特定の日付および時刻を定義できます。
ROMベース[コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]	BIOSによって制御されるシステム設定を確認およびカスタマイズします。
ビデオによるシステム/緊急ROMフラッシュ リカバリ	破損したフラッシュROM内のシステムBIOSをリカバリします。
複製セットアップ	ディスクまたはUSBフラッシュドライブ上の読み取り可能なファイルにBIOS設定を保存します。その後、Reset.exeユーティリティは、[コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]を起動することなく、展開されたシステムでこれらの設定を複製できます。
SMBIOS	システム管理情報用のSystem Management BIOS 2.7。
起動制御	サポート対象のデバイスでリムーバブル メディアからの起動を無効にします。

システム技術仕様

メモリ変更警告	メモリが取り除かれたり変更されたりした場合、管理コンソールに警告します。
温度警告	シャーシ内の温度状態を監視します。3つのモード： - [NORMAL] (◆正常◆) - 正常の温度範囲。 - [ALERTED] (◆警告◆) - 過熱が検出されています。シャットダウンを回避する、またはより円滑なシステム シャットダウンを提供するためのアクションを行えるよう、フラグが立てられます。 - [SHUTDOWN] (◆シャットダウン◆) - 過熱が発生しています。ハードウェア コンポーネントの損傷が発生する前に、警告なしでコンピューターを自動的にシャットダウンします。
リモートROMフラッシュ機能	中央のネットワーク コンソールから安全でフェイルセーフのROMイメージ管理を提供します。
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)	システムは低電力モード(スリープ モード)に入り、そのモードから復帰できます。 オペレーティング システムは、動的なワークロードに基づいてシステムの電力消費を制御できます。個々のカードおよび周辺機器を、システムの他の要素に影響を及ぼすことなく、低電力または電源切断状態にすることを可能にします。 64ビット オペレーティング システムとの完全な互換性のためにACPI 2.0をサポートします。
オーナーシップ タグ	BIOSスプラッシュ画面に表示される、不揮発性メモリに記憶されるユーザー定義の文字列。
リモート復帰/リモート シャットダウン	システム管理者は、リモート場所から、クライアント コンピューターの電源投入、再起動、および電源切断を行うことができます。
すぐに利用可能なPC (RAMにサスペンド - ACPI スリープ状態S3)	短い再開時間により、非常に低い電力消費を可能にします。
F12によるリモートシステムインストール(PXE 2.1) (サーバーからのリモート起動)	新規または既存のシステムはネットワークを介して起動し、オペレーティング システムを含むソフトウェアをダウンロードできます。
ROMリビジョン レベル	[コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]でシステムBIOSリビジョン レベルを報告します。バージョンは、業界標準インターフェイス(SMBIOS)を介して利用できるため、管理SWアプリケーションはこの情報を使用して報告できます。
システム ボード リビジョン レベル	管理ソフトウェアはシステム ボードのリビジョン レベルを読み取ることができます リビジョン レベルは、HWIにデジタルでエンコードされており、変更できません
起動診断 (Power-On Self Test)	選択可能なテスト レベルで、起動時のシステム状態を評価します。
新規ハードウェア インストール時の自動セットアップ	システムは、新規ハードウェアの追加を自動検出します。
キーボード不要の操作	システムをキーボードなしで起動できます。
ローカライズされたROMセットアップ	共通BIOSイメージは、[コンピューター セットアップ(F10)ユーティリティ]のメニューを、キーボード マッピングがローカライズされた12言語でサポートします。
アセット タグ	ユーザーまたはMISは不揮発性メモリで一意的タグ文字列を設定できます。
スロットごとの制御	I/Oスロット パラメーター(オプションのROM有効/無効、バス遅延)を個別に構成できます。
アダプティブ冷却	最適な音響を実現するために、ファン制御パラメーターは、検出されたハードウェア構成に従って設定されます。
起動前の診断	早期の(画面表示前の)重大なエラーは、電源ランプのビープ音および点滅によって報告されます。
業界標準仕様サポート	
業界標準	BIOSによってサポートされるリビジョン
UEFI仕様リビジョン	2.3.1
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface、バージョン2.0c
ATA (IDE)	ATA/ATAPI-6(AT Attachment 6 with Packet Interface)、リビジョン3b

システム技術仕様

CD起動	"El Torito" Bootable CD-ROM Format Specification/バージョン1.0
EDD	- Enhanced Disk Drive Specification/バージョン1.1 - BIOS Enhanced Disk Drive Specification/バージョン3.0
EHCI	Enhanced Host Controller Interface for Universal Serial Bus、リビジョン1.0
PCI	- PCI Local Bus Specification、リビジョン2.3 - PCI Power Management Specification、リビジョン1.1 - PCI Firmware Specification、リビジョン3.0、ドラフト0.7
PCI Express	PCI Express Base Specification、リビジョン2.0 PCI Express Base Specification、リビジョン3.0
PMM	POST Memory Manager Specification、バージョン1.01
SATA	Serial ATA Specification、リビジョン1.0a Serial ATA 3 Gb/s: Serial ATA Specification、リビジョン2.5 Serial ATA 6 Gb/s: Serial ATA Specification、リビジョン3.0
SPD	PC SDRAM Serial Presence Detect (SPD) Specification、リビジョン1.2B
TPM	Trusted Computing Group TPM Specification/バージョン1.2
UHCI	Universal Host Controller Interface Design Guide、リビジョン1.1
USB	Universal Serial Busリビジョン1.1仕様 Universal Serial Busリビジョン2.0仕様 Universal Serial Busリビジョン3.0仕様
SMBIOS	System Management BIOS Reference Specification、バージョン2.7
	外部BIOSシミュレーターについては、 http://h20464.www2.hp.com/index.html (英語サイト)をご覧ください。

外部BIOSシミュレーターについては、<http://h20464.www2.hp.com/index.html> (英語サイト)をご覧ください。

社会的および環境に対する責任

エコラベル認定および宣言	<p>本製品は以下の承認を受けている、または承認の認定途中です。これらの評価のラベルが1つまたは複数貼付されている場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 国際エネルギー スター (特定の構成で利用可能な省エネルギー機能 - Windowsのみ) 米国FEMP (Federal Energy Management Program) China Energy Conservation Program ECO宣言 (TED)
バッテリー	<p>本製品のバッテリーは、EU Directive 2006/66/ECバッテリー サイズに準拠しています: CR2032 (コイン型バッテリー) バッテリーの種類: リチウム メタル</p> <p>本製品のバッテリーには以下は含まれていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 質量で5 ppmを超える水銀 質量で10 ppmを超えるカドミウム 質量で40 ppmを超える鉛
制限された原料使用	<p>本製品は、HP環境関連一般仕様書 (GSE) に規定されている原料制限に従っています。http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf (英語サイト)</p> <p>Hewlett-Packardは、European UnionのRoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directiveを含め、すべての適用される環境法および規制に準拠するように努めています。HPの目標は、RoHS Directiveの要件を世界各国で満たすことによって、準拠義務を超えることです。</p>

システム技術仕様

低ハロゲンに関する声明	本製品は、電源コード、ケーブル、周辺機器、およびお客様が構成可能な次の内蔵コンポーネントを除き、低ハロゲンです。3.5インチSAS HDD、LSI 9260-8i SAS 6 Gb/s ROC RAIDカード、Creative Recon3D PCIeオーディオカード、水冷冷却装置、およびBroadcom 5761 Gigabit PCIe NICは低ハロゲンではありません。購入後に取得する保守部品は、低ハロゲンではない場合があります。
廃棄管理およびリサイクル	HPでは、多くの地域で、廃棄するHP製品の返却およびリサイクルプログラムを提供しています。製品をリサイクルする場合は、 http://h50055.www5.hp.com/ipg/supplies/recycling/hardware/jp/ja/index.asp にアクセスするか、最寄りのHP販売オフィスにお問い合わせください。HPに返却された製品は、責任を持ってリサイクル、復元、または廃棄されます。本製品は、適切に廃棄された場合、質量で90%以上リサイクル可能です。
HPの環境情報	HPの環境に対する取り組みについて詳しくは、以下を参照してください。 Global Citizenship Report http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html (英語サイト) エコラベル認定 http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html (英語サイト) ISO 14001証明書: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html (英語サイト)
追加情報	<ul style="list-style-type: none"> 本HP製品は、WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive - 2002/96/ECに準拠するように設計されています。 本製品で使用されている25グラムを超えるプラスチック部品には、ISO 11469およびISO1043に従ってマークが付けられています。 本製品は、適切に廃棄された場合、90%以上リサイクル可能です。 <p>EPEAT Gold - 本製品の国際エネルギー スター認定構成は、HPがワークステーション製品を登録しているGoldレベルでのIEEE 1680 (EPEAT) 標準に準拠しています。各国の登録状況については、http://ww2.epeat.net/CompanyDetail.aspx?CompanyID=24 (英語サイト)をご覧ください。</p>
梱包	HPワークステーション製品の梱包は、HPの環境に関する一般的な仕様 (http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/gen_specifications.html (英語サイト)) を満たしています。 <ul style="list-style-type: none"> HP標準011-1 (環境に関する一般的な仕様) に規定されている制限物質は含まれていません オゾン破壊物質 (ODS) は含まれていません すべての重金属 (鉛、水銀、カドミウム、または六価クロム) の合計100 ppmを超える重金属は含まれていません 梱包材料では使用済みのリサイクルされた材料を最大限使用しています。 すべての梱包材料はリサイクル可能です すべての梱包材料は、分解しやすいように設計されています 輸送の燃料効率を向上させるために、梱包品のサイズと質量が削減されています プラスチックの梱包材料には、ISO 11469およびDIN 6120標準のフォーマットに従いマークが付けられています
梱包材料	
内部	クッションおよびプラスチック バッグは、低密度ポリエチレン (LDPE) で作られています。
外部	外側の箱、アクセサリの箱、および挿入物は段ボール板紙で作られています。

管理機能

業界標準仕様	本製品は、管理機能に関する以下の業界標準仕様を満たしています。
--------	---------------------------------

システム技術仕様

	<ul style="list-style-type: none"> DASH 1.1 (Intel LAN on motherboard経由)
Intel AMT (Active Management Technology)	<p>Intel® AMT (Active Management Technology) 9.1</p> <p>システムの状態または電源の状態にかかわらず、ネットワーク接続されたクライアント システムをリモート検出、修復、および保護するための最新で最も効果的なツールをIT管理者に提供する、リモート管理機能の高度なセット。AMT 9.1には、以下の高度な管理機能が含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源管理 (投入、切断、リセット、適切なシャットダウン、スリープ、およびハイバネーション) 最大省電力でのサポート (シャットダウンおよびハイバネーション モード) ハードウェア インベントリ (BIOSおよびファームウェア リビジョンを含む) ハードウェア警告 エージェント プレゼンス システム防御フィルター SOL (Serial Over LAN) IDEリダイレクト ME WOL (ウェイク オンLAN) DASH 1.1 準拠 IPv6サポート Fast Call for Help - ファイアウォール内部または外部のクライアントは、BIOS画面、定期的な接続、または警告によってトリガーされる接続を介して、ヘルプへの通話を開始できます。 リモートからの定期保守 - システムが保守のためにITまたはサービス プロバイダー コンソールに接続する時期をあらかじめスケジュールします。 リモート警告 - 問題が発生した場合にITまたはサービス プロバイダーに自動的に警告します アクセス モニター - セキュリティ要件をサポートするためにIntel® AMTのアクションを監視します PCアラーム クロック Microsoft NAPサポート ホスト ベース セットアップおよび構成 管理エンジン (ME) ファームウェア ロール バック ローカル時間のUTCとの同期、リモート メモリ ダンプ コマンド - デバッグ用のメモリ ダンプを作成します
Intel® vPro™テクノロジー	<p>HP Z840 Workstationは、以下のように構成されている場合、Intel® vProテクノロジーをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> Intel® vPro™テクノロジー搭載のIntel® Xeon®プロセッサE5-1600 v3製品ファミリまたはE5-2600 v3製品ファミリ Intel® C610チップセット Intel® I218LM GbE LAN
リモート管理ソフトウェアソリューション	<p>HP Z840 Workstationは、以下のリモート管理ソフトウェア コンソールでサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> LANDesk Management Suite (HP推奨ソリューション) Microsoft System Center Configuration Manager HP Client Automation Enterprise <p>管理ニーズに関する質問またはサポートについては、http://www.hp.com/go/easydeploy/ (英語サイト)を参照してください。</p>
System Software Manager	<p>SSMに関する質問またはサポートについては、http://www.hp.com/go/ssm (英語サイト)を参照してください。</p>
サービス、サポート、および保証	<p>オンサイト保証およびサービス(注1): 3年間の限定された保証およびサービス提供は、部品および作業に対するサービスをオンサイトで翌営業日(注2)に提供し、午前8時~午後5時の無料の電話サポートが含まれます(注3)。グローバル対応(注2)により、ある国で購入し、制約のない別の国に移動した製品には、元の保証およびサービス提供がすべて引き続き適用されます。</p>

システム技術仕様

	<p>注1: 条件は国ごとに異なる場合があります。特定の制限および除外が適用されます。</p> <p>注2: オンサイト サービスは、HPとHPの認定サードパーティ プロバイダーとの間のサービス契約に従って提供される場合があります、一部の国では利用できません。グローバル サービスの応答時間は、商取引上の合理的なベスト エフォートに基づき、国ごとに異なる場合があります。</p> <p>注3: 電話によるテクニカル サポートは、HPが構成し、HP製およびHPが認定したサードパーティ製のハードウェアおよびソフトウェアにのみ適用されます。無料通話および24時間365日対応のサポート サービスは、一部の国では利用できない場合があります。</p> <p>HP Care Packサービスは、標準保証を超えてサービス契約を拡張します。サービスはハードウェア購入日から開始します。HP製品に適したレベルのサービスを選択するには、http://www.hp.com/go/lookuptool/にある[HP Care Pack Services Lookup Tool]を使用してください。製品ごとの詳しいHP Care Packサービス情報については、http://www.hp.com/hps/carepack/ (英語サイト)を参照してください。HP Care Packのサービス レベルおよび応答時間は、地域ごとに異なる場合があります。HPのサービスは、ご購入時にお客様に提供または提示される、適用可能なHPサービス使用条件に準拠します。お客様によっては該当地域の法令に従ってその他の法的権利を有することもあり、当該権利はHPサービス使用条件またはお使いのHP製品に付属のHP限定保証による影響を一切受けません。</p>
製品変更通知	<ul style="list-style-type: none"> • ユーザーが定義したプロファイルに基づき、製品変更通知 (PCN) および技術情報を電子メールでお客様にプロアクティブに通信するためのプログラム。 • PCNは、工場で実装されるハードウェアおよびソフトウェア変更を事前に通知して、移行を計画するための時間を提供します。 • 技術情報は、正確で効果的な問題解決を提供して、テクニカル サポートに問い合わせる必要性を大幅に減らします。

その他オプション製品の技術仕様については下記のQuickSpecs (英語版)をご参照ください。

<http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/productbulletin.html#!spectype=worldwide>

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。Intel、インテル、Xeon、およびQuickPathは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標です。MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。